

第52回エンジニアリングセラミックスセミナー

「エンジニアリングセラミックスに関わるプロセス技術の革新II」

概要

先進セラミックス材料は環境・エネルギー分野でのさらなる実用化拡大が期待されている。先進セラミックス材料の材料開発においては、高機能化・多機能化はもちろんのこと、SDGsを見据えたより効率的かつ革新的なセラミックス製造ならびに組織制御技術が求められる。本セミナーでは、セラミックス焼結の科学・技術に携わられる先生方をお招きし、セラミックスの低温・高速での焼結・高密度化に寄与する新たな技術とその学理についてご講演をいただく。

主催：日本セラミックス協会エンジニアリングセラミックス部会

協賛：日本化学会，日本金属学会，耐火物技術協会，粉体粉末冶金協会，粉体工学会，日本ファインセラミックス協会（予定）

開催日時：2021年11月30日（火）

場所：オンライン（Zoom）開催

ご入金確認次第，URL，ミーティングID等をお送りいたします。

定員：100名

参加費：会員 10,000円（協賛学協会含む），学生会員 3,000円，非会員 15,000円
（申込時入会は会員扱）（消費税・テキスト代込）

申込方法：HP（http://www.ceramic.or.jp/bkouon/index_j.html）の申込フォームよりお申し込みください。参加費はセミナー一週間前までに銀行振込にてご送金ください。お申込後の取り消しによる返金はいたしません。

問合せ先：〒169-0073 東京都新宿区百人町2-22-17

公益社団法人日本セラミックス協会エンジニアリングセラミックス部会

TEL：03-3362-5231，FAX：03-3362-5714，Email：encera@cersj.org

振込先：三菱東京UFJ銀行千里中央支店（普）0073211

（公社）日本セラミックス協会エンジニアリングセラミックス部会 名義
銀行振込の振込受領書を領収書にかえさせていただきます

【プログラム】

13:30-13:35 開会挨拶

部会長 TOTO（株）清原正勝

13:35-14:15 「コールドシンタリング法による低温焼結と実用化に向けた課題」

（株）村田製作所 舟橋修一

14:15-14:55 「パルス通電加圧焼結（SPS）法による実用材料の開発と製品化」

（株）エヌジェーエス 安藤秀夫

休憩

15:20-16:00 「焼結緻密化のシミュレーションと低温焼結の試み」

物質・材料研究機構 金炳男

16:00-16:40 「ミリ波照射下でのセラミックスの物質輸送現象」

岡山大学 岸本昭

16:40-17:20 「フラッシュ焼結技法の進展と今後の展開」

名古屋大学 山本剛久

17:20 閉会挨拶

副部会長 ファインセラミックスセンター 北岡諭